



2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年5月15日

上場会社名 タツモ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6266 URL <https://tazmo.co.jp/irlibrary/#irlib-report01>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 佐藤 泰之
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 吉國 久雄 TEL 086-239-5000
 配当支払開始予定日 —
 決算補足説明資料作成の有無 : 有
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2026年12月期第1四半期の連結業績（2026年1月1日～2026年3月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年12月期第1四半期	5,967	△20.6	86	△92.9	186	△84.1	111	△87.0
2025年12月期第1四半期	7,516	27.3	1,210	112.2	1,176	77.7	855	101.3

(注) 包括利益 2026年12月期第1四半期 216百万円 (△48.6%) 2025年12月期第1四半期 420百万円 (△49.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年12月期第1四半期	7.71	—
2025年12月期第1四半期	58.70	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年12月期第1四半期	46,062	26,760	57.0	1,814.18
2025年12月期	46,893	27,037	56.6	1,834.03

(参考) 自己資本 2026年12月期第1四半期 26,260百万円 2025年12月期 26,542百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年12月期	—	0.00	—	34.00	34.00
2026年12月期	—	—	—	—	—
2026年12月期（予想）	—	0.00	—	34.00	34.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2026年12月期の連結業績予想（2026年1月1日～2026年12月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期（累計）	15,570	△7.3	890	△64.7	800	△66.4	600	△63.5	40.96
通期	35,500	0.2	3,600	△24.5	3,500	△30.1	2,500	△29.4	170.65

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無
新規 ー社 (社名) ー、除外 ー社 (社名) ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2026年12月期 1 Q	14,842,354株	2025年12月期	14,842,354株
② 期末自己株式数	2026年12月期 1 Q	367,446株	2025年12月期	370,046株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2026年12月期 1 Q	14,472,541株	2025年12月期 1 Q	14,579,555株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 経営成績等の概況 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
(セグメント情報等の注記)	9
3. 補足情報	10
(受注状況)	10

1. 経営成績等の概況

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間における経営環境は、国内経済においては、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続いたものの、原材料価格やエネルギー価格の高止まり、為替相場の変動などにより、先行きについては依然として不透明な状況で推移いたしました。

当社グループが属する半導体業界におきましては、AIサーバー向けを中心に需要は引き続き旺盛に推移しており、これに伴い、メモリー半導体については供給不足の状況が継続し、価格の上昇基調が見られました。

このような状況のなか当社グループは、中長期的な成長に向けて、顧客ニーズに対応した装置の開発や生産活動に注力してまいりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は59億67百万円（前年同期比20.6%減）、営業利益86百万円（前年同期比92.9%減）、経常利益1億86百万円（前年同期比84.1%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益1億11百万円（前年同期比87.0%減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

なお、当第1四半期連結会計期間より、報告セグメント「プロセス機器事業」内の「コーター」を「半導体装置」に含めて区分をしており、以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後の区分に組み替えた数値で比較しております。

（プロセス機器事業）

半導体装置部門につきましては、概ね計画通りに検収が進み、売上高は25億93百万円（前年同期比3.0%増）となりました。

搬送装置部門につきましては、受注状況は回復傾向にあるものの、売上計上できる案件が少なかったため、売上高は14億23百万円（前年同期比20.2%減）となりました。

洗浄装置部門につきましては、ウェーハメーカーの設備投資が鈍化していることから、売上高は7億20百万円（前年同期比43.4%増）となりました。

以上の結果、プロセス機器事業の売上高は47億37百万円（前年同期比1.4%減）、営業利益60百万円（前年同期比92.0%減）となりました。

（金型・樹脂成形事業）

金型・樹脂成形事業につきましては、概ね計画通りであったものの、原材料の高騰や工場移転費用などの発生により、売上高は2億78百万円（前年同期比5.2%減）、営業損失0百万円（前年同期は38百万円の営業利益）となりました。

（表面処理用機器事業）

表面処理用機器事業につきましては、売上計上できる案件が少なかったため、売上高9億51百万円（前年同期比60.7%減）、営業利益14百万円（前年同期比96.3%減）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は366億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億4百万円減少しました。主な要因は、「受取手形及び売掛金」の増加1億45百万円、「現金及び預金」の減少8億8百万円、「電子記録債権」の減少1億95百万円、「棚卸資産」の減少2億60百万円によるものであります。有形固定資産は81億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億66百万円増加しました。主な要因は、「機械装置及び運搬具(純額)」の増加3億33百万円によるものであります。無形固定資産は1億96百万円となり、前連結会計年度末より3百万円減少しました。主な要因は、「その他」の減少2百万円によるものであります。投資その他の資産は10億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ10百万円増加しました。主な要因は、「投資有価証券」の増加2百万円、「その他」の増加7百万円によるものであります。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ8億30百万円減少し、460億62百万円となりました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における流動負債は129億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億28百万円の減少となりました。主な要因は、「契約負債」の増加11億22百万円、「電子記録債務」の減少17億28百万円、「未払金」の減少5億70百万円、「未払法人税等」の減少6億97百万円によるものであります。

固定負債は63億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億74百万円の増加となりました。主な要因は、「長期借入金」の増加8億28百万円によるものであります。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ5億53百万円減少し、193億2百万円となりました。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は267億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億77百万円の減少となりました。主な要因は、「為替換算調整勘定」の増加99百万円、「利益剰余金」の減少3億86百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2026年2月13日に公表いたしました「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の2026年12月期の連結業績予想(2026年1月1日～2026年12月31日)から変更はしておりません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,274,465	15,465,634
受取手形及び売掛金	3,019,861	3,165,131
電子記録債権	2,539,187	2,343,919
棚卸資産	15,410,284	15,149,691
その他	650,779	549,096
貸倒引当金	△84,608	△68,108
流動資産合計	37,809,969	36,605,363
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,672,924	3,675,450
機械装置及び運搬具（純額）	1,651,827	1,985,539
土地	1,449,516	1,449,516
その他（純額）	1,038,510	1,068,476
有形固定資産合計	7,812,778	8,178,983
無形固定資産		
ソフトウェア	154,900	153,951
その他	44,566	42,411
無形固定資産合計	199,466	196,362
投資その他の資産		
投資有価証券	23,924	26,322
繰延税金資産	651,882	652,950
その他	395,188	402,305
投資その他の資産合計	1,070,995	1,081,579
固定資産合計	9,083,241	9,456,924
資産合計	46,893,210	46,062,288

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,565,571	1,694,955
電子記録債務	2,011,901	282,932
短期借入金	3,265,446	3,707,306
未払金	1,595,168	1,024,759
未払法人税等	912,101	214,184
契約負債	3,659,601	4,782,566
賞与引当金	337,947	507,387
製品保証引当金	638,228	561,126
株式給付引当金	11,183	12,301
その他	395,937	177,141
流動負債合計	14,393,086	12,964,661
固定負債		
長期借入金	4,645,009	5,473,854
株式給付引当金	344,706	352,116
役員退職慰労引当金	35,040	36,188
退職給付に係る負債	82,711	83,029
資産除去債務	211,336	258,198
その他	143,921	134,162
固定負債合計	5,462,724	6,337,550
負債合計	19,855,811	19,302,211
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,568,590	3,568,590
資本剰余金	3,420,931	3,420,931
利益剰余金	19,140,774	18,754,476
自己株式	△739,532	△735,378
株主資本合計	25,390,763	25,008,620
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△176	△122
為替換算調整勘定	1,152,556	1,252,037
退職給付に係る調整累計額	△486	△486
その他の包括利益累計額合計	1,151,892	1,251,427
非支配株主持分	494,741	500,029
純資産合計	27,037,398	26,760,077
負債純資産合計	46,893,210	46,062,288

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年3月31日)
売上高	7,516,604	5,967,096
売上原価	4,910,409	4,342,419
売上総利益	2,606,194	1,624,676
販売費及び一般管理費	1,395,772	1,538,472
営業利益	1,210,422	86,204
営業外収益		
受取利息	10,362	45,578
為替差益	-	58,063
補助金収入	1,351	900
その他	9,166	13,728
営業外収益合計	20,880	118,270
営業外費用		
支払利息	18,859	17,354
為替差損	28,865	-
その他	6,959	166
営業外費用合計	54,684	17,520
経常利益	1,176,618	186,954
税金等調整前四半期純利益	1,176,618	186,954
法人税等	312,894	76,461
四半期純利益	863,724	110,492
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	7,860	△1,024
親会社株主に帰属する四半期純利益	855,863	111,517

(四半期連結包括利益計算書)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年3月31日)
四半期純利益	863,724	110,492
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△64	53
為替換算調整勘定	△442,769	105,833
持分法適用会社に対する持分相当額	△143	△40
その他の包括利益合計	△442,977	105,847
四半期包括利益	420,746	216,339
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	437,953	211,052
非支配株主に係る四半期包括利益	△17,206	5,287

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年3月31日)
減価償却費	262,403千円	247,951千円

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業	表面処理用 機器事業			
売上高						
半導体装置	2,517,445	—	—	2,517,445	—	2,517,445
搬送装置	1,783,436	—	—	1,783,436	—	1,783,436
洗浄装置	502,691	—	—	502,691	—	502,691
金型・樹脂成形	—	293,961	—	293,961	—	293,961
表面処理用機器	—	—	2,419,070	2,419,070	—	2,419,070
顧客との契約から生じる収益	4,803,572	293,961	2,419,070	7,516,604	—	7,516,604
その他の収益	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	4,803,572	293,961	2,419,070	7,516,604	—	7,516,604
セグメント間の内部売上高 又は振替高	65,331	30,414	—	95,746	△95,746	—
計	4,868,904	324,376	2,419,070	7,612,351	△95,746	7,516,604
セグメント利益	752,410	38,171	394,789	1,185,371	25,051	1,210,422

(注) 1. 当第一四半期連結会計期間より、プロセス機器事業の「コーター」は「半導体装置」に含めて区分する方法に変更しておりますので、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報についても、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

2. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。

3. セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 2026年1月1日 至 2026年3月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業	表面処理用 機器事業			
売上高						
半導体装置	2,593,061	—	—	2,593,061	—	2,593,061
搬送装置	1,423,084	—	—	1,423,084	—	1,423,084
洗浄装置	720,990	—	—	720,990	—	720,990
金型・樹脂成形	—	278,792	—	278,792	—	278,792
表面処理用機器	—	—	951,167	951,167	—	951,167
顧客との契約から生じる収益	4,737,136	278,792	951,167	5,967,096	—	5,967,096
その他の収益	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	4,737,136	278,792	951,167	5,967,096	—	5,967,096
セグメント間の内部売上高 又は振替高	84,481	1,131	—	85,612	△85,612	—
計	4,821,617	279,924	951,167	6,052,709	△85,612	5,967,096
セグメント利益又は損失 (△)	60,395	△991	14,660	74,064	12,140	86,204

(注) 1. 当第一四半期連結会計期間より、プロセス機器事業の「コーター」は「半導体装置」に含めて区分する方法に変更しております。

2. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。

3. セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

3. 補足情報

(受注状況)

当第1四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

1. 受注高

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年3月31日) (千円)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年3月31日) (千円)	前年同期比 (%)
プロセス機器事業	3,592,269	14,641,393	407.6
+			
半導体装置	1,305,609	11,710,954	897.0
搬送装置	2,004,584	2,544,662	126.9
洗浄装置	282,075	385,776	136.8
金型・樹脂成形事業	336,024	264,458	78.7
表面処理用機器事業	502,273	1,153,115	229.6
合計	4,430,568	16,058,967	362.5

(注) 1. 当第一四半期連結会計期間より、プロセス機器事業の「コーター」は「半導体装置」に含めて区分する方法に変更しております。なお前第1四半期連結累計期間の受注高については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2. 受注残高

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年3月31日) (千円)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年3月31日) (千円)	前年同期比 (%)
プロセス機器事業	24,193,278	27,618,004	114.2
+			
半導体装置	18,159,172	21,960,221	120.9
搬送装置	3,946,598	3,938,575	99.8
洗浄装置	2,087,508	1,719,207	82.4
金型・樹脂成形事業	212,253	156,022	73.5
表面処理用機器事業	3,656,475	1,976,029	54.0
合計	28,062,007	29,750,055	106.0

(注) 1. 当第一四半期連結会計期間より、プロセス機器事業の「コーター」は「半導体装置」に含めて区分する方法に変更しております。なお前第1四半期連結累計期間の受注残高については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。